

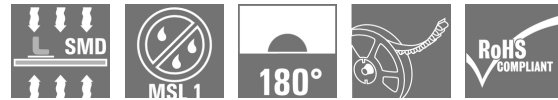
**RJ45C5 S1V 2.7N4N RL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



L'assortimento prodotti include i seguenti modelli:

- 90° orizzontale e 180° verticale
- Con gancio verso l'alto / gancio verso il basso
- Processi di saldatura THT, THR o SMD
- Ampia gamma di forme diverse, anche con LED integrati e linguette per contatto schermato
- Categoria di prestazione da Cat. 3 a Cat. 6
- Versione con imballaggio in vassoio (TY) o su rotolo (Tape-on-Reel, RL)
- Compatibile con connettore RJ45 modulare secondo ANSI / TIA-1096-A e IEC 60603
- Rigidità dielettrica  $\geq 1500$  V AC RMS (valore di picco 2250 V AC) secondo IEEE 802.3
- Rigidità dielettrica  $\geq 1500$  V AC (valore di picco)  $\geq 1500$  V DC secondo IEC 60603

Caratteristiche e vantaggi:

- Intervallo di temperatura ampliato da  $-40$  °C a  $+85$  °C per massime prestazioni
- Strato dorato rinforzato ( $30\mu$ "") per una migliore protezione anticorrosione
- La distanza di almeno 0,3 mm assicura una perfetta saldatura

**Dati generali per l'ordinazione**

|             |   |
|-------------|---|
| Versione    | Connettore per circuito stampato, Jack RJ45, Cat. 5 , Collegamento a saldare SMD, 180°, Linguette di schermatura: nessuno, 30...80 $\mu$ " Ni / $\geq 30$ $\mu$ " Au , LED: No, Numero di poli: 8, Tape |
| Nr.Cat.     | <a href="#">1433900000</a>  |
| Tipo        | RJ45C5 S1V 2.7N4N RL  |
| GTIN (EAN)  | 4050118238587   |
| CPZ         | 300 Pezzo   |
| Imballaggio | Tape  |

## RJ45C5 S1V 2.7N4N RL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Dati tecnici

## Dimensioni e pesi

|                     |            |                      |            |
|---------------------|------------|----------------------|------------|
| Profondità          | 20,05 mm   | Profondità (pollici) | 0,789 inch |
| Posizione verticale | 13,2 mm    | Altezza (pollici)    | 0,52 inch  |
| Altezza minima      | 13,2 mm    | Larghezza            | 16,1 mm    |
| Larghezza (pollici) | 0,634 inch | Peso netto           | 3,467 g    |

## Temperature

|                                |        |                                |       |
|--------------------------------|--------|--------------------------------|-------|
| Temperatura d'esercizio , min. | -40 °C | Temperatura d'esercizio , max. | 85 °C |
|--------------------------------|--------|--------------------------------|-------|

## Specifiche di sistema

|   |  |                                |                                    |
|---|--|--------------------------------|------------------------------------|
| Angolo di uscita                                | 180°                                   | Cablaggio                      | 8 poli                             |
| Categoria                                       | Cat. 5                                 | Categoria di prestazione       | Cat. 5                             |
| Cicli di inserimento                            | 750                                    | Complanarità:                  | 100 µm                             |
| Dimensioni del codolo a saldare                 | ottagonale                             | Famiglia prodotti              | OMNIMATE Data - Jack modulare RJ45 |
| Grado di protezione                             | IP20                                   | LED                            | No                                 |
| Linguette di schermatura                        | nessuno                                | Lunghezza spina a saldare (l)  | 3,5 mm                             |
| Materiale della schermatura                     | Lega di rame                           | Montaggio su circuito stampato | Collegamento a saldare SMD         |
| Numero di codoli a saldare per polo             | 1                                      | Numero di poli                 | 8                                  |
| Passo in mm (P)                                 | 1,27 mm                                | Passo in pollici (P)           | 0,05 inch                          |
| Processo di saldatura                           | Saldatura Reflow,<br>Saldatura manuale | Schermatura                    | Si                                 |
| Superficie di schermatura                       | nichelato                              | Tipo di collegamento           | Collegamento a saldare SMT         |
| Tolleranza della posizione del codolo a saldare | ± 0,1 mm                               |                                |                                    |

## Caratteristiche elettriche

|                                       |           |  |                      |
|---------------------------------------|-----------|--|----------------------|
| Corrente nominale                     | 1,5 A     | PoE / PoE+                             | secondo IEEE 802.3at |
| Resistenza contro l'isolamento        | ≥ 500 MΩ  | Rigidità dielettrica contatto-contatto | 1000 V DC            |
| Rigidità dielettrica contatto-schermo | 1500 V DC | Tensione nominale                      | 125 V                |

## Standard

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Connettori a norma | IEC 60603-7-5 1 |
|--------------------|-----------------|

## Dati del materiale

|   |                            |   |                            |
|---|----------------------------|---|----------------------------|
| Materiale isolante                            | PA 9T                      | Colori                                    | nero                       |
| Tabella dei colori (simile)                   | RAL 9011                   | Gruppo materiali isolanti                 | II                         |
| Comparative Tracking Index (CTI)              | ≥ 500                      | Resistenza contro l'isolamento            | ≥ 500 MΩ                   |
| Moisture Level (MSL)                          | 1                          | Classe d'infiammabilità UL 94             | V-0                        |
| Materiale base dei contatti                   | Fosforo bronzo             | Superficie dei contatti                   | Oro su nichel              |
| Struttura a strati del collegamento a saldare | 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Sn | Struttura a strati del connettore maschio | 30...80 µ" Ni / ≥ 30 µ" Au |
| Temperatura di magazzinaggio, min.            | -40 °C                     | Temperatura di magazzinaggio, max.        | 85 °C                      |
| Temperatura d'esercizio , min.                | -40 °C                     | Temperatura d'esercizio , max.            | 85 °C                      |

**RJ45C5 S1V 2.7N4N RL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Dati tecnici****Imballaggio**

|  |        |                         |                               |
|--|--------|-------------------------|-------------------------------|
| Imballaggio                              | Tape   | Lunghezza VPE           | 332 mm                        |
| Larghezza VPE                            | 332 mm | Altezza VPE             | 53 mm                         |
| Diametro $\varnothing$ bobina nastro (A) | 330 mm | Resistenza superficiale | $R_s = 10^9 - 10^{12} \Omega$ |

**Classificazioni**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC002637    | ETIM 7.0    | EC002637    |
| ETIM 8.0    | EC002637    | ECLASS 9.0  | 27-44-04-02 |
| ECLASS 9.1  | 27-44-04-02 | ECLASS 10.0 | 27-44-04-02 |
| ECLASS 11.0 | 27-46-02-01 | ECLASS 12.0 | 27-46-02-01 |

**Omologazioni**

Omologazioni



|                        |             |
|------------------------|-------------|
| ROHS                   | Conforme    |
| UL File Number Search  | Sito web UL |
| N° certificato (cURus) | E471884     |

**Download**

|  |  |
|--|--|
| Omologazione/Certificato/Documento di conformità | <a href="#">Certificate of Compliance</a>  |
| Dati ingegneristici                              | <a href="#">CAD data – STEP</a>  |
| Documentazione utente                            | <a href="#">MAN IE GUIDE DE</a><br><a href="#">MAN IE GUIDE EN</a>   |
| Cataloghi  | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>   |
| Brochure   | <a href="#">MB FREECONTACT EN</a><br><a href="#">FL FIELDWIRING EN</a><br><a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a><br><a href="#">PI PROFINET CABLING EN</a> |

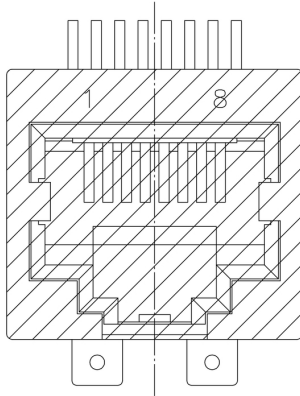
**Foglio dati**

**RJ45C5 S1V 2.7N4N RL**

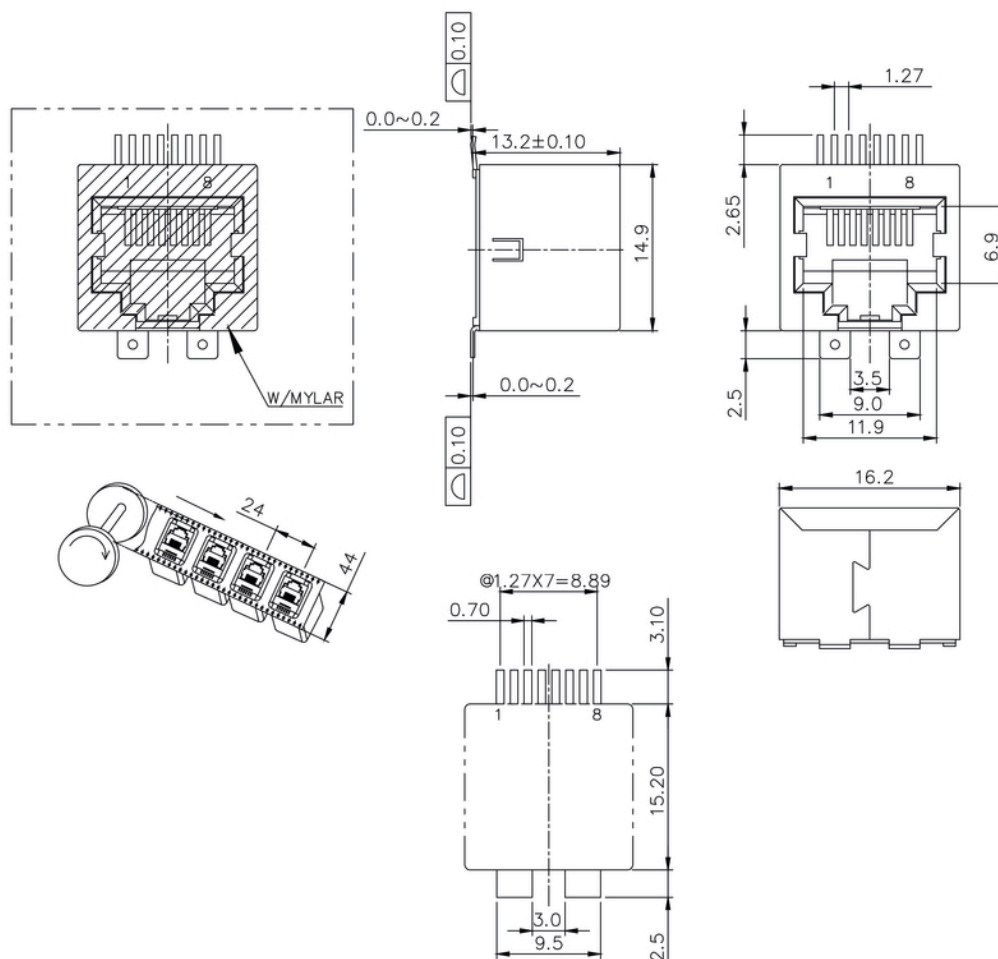
**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Disegni**



Dimensional drawing



**RJ45C5 S1V 2.7N4N RL**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Disegni**

| Code                             | Value              | Description                                 |
|----------------------------------|--------------------|---|
| RJ45                             | G1                 | RJ45G1                                      |
| R                                | R                  | R   |
| U                                | U                  | U   |
| 3.2                              | 3.2                | 3.2   |
| E                                | E                  | E   |
| 4                                | 4                  | 4   |
| GY/GY                            | GY/GY              | GY/GY                                       |
| TY                               | TY                 | TY  |
| <b>RJ45G1 R1U 3.2E4GY/GY TY</b>  |                    |   |
| <b>Packaging</b>                 | <b>TY</b>          | Tray in box (manual assembly)               |
|                                  | <b>RL</b>          | Tape on Reel (automated assembly)           |
| <b>LED</b>                       | <b>Y/G</b>         | Yellow/Green                                |
|                                  | <b>G/Y</b>         | Green/Yellow (standard)                     |
|                                  | <b>GY/GY</b>       | Green-Yellow/Green-Yellow                   |
|                                  | <b>O/G</b>         | Orange/Green                                |
|                                  | <b>R/O</b>         | Red/Orange                                  |
|                                  | <b>...</b>         | ... (further combinations possible)         |
|                                  | <b>N</b>           | without LED                                 |
| <b>Contact surface thickness</b> | <b>4</b>           | 1 = 3µ, 2 = 6µ, 3 = 15µ, 4 = 30µ, 5 = 50µ   |
| <b>EMI tabs (ground fingers)</b> | <b>E</b>           | E = with EMI tabs                           |
|                                  | <b>N</b>           | N = without EMI tabs                        |
| <b>Solder Pin length</b>         | <b>3.2</b>         | 3.2 mm                                      |
|                                  | <b>1.6</b>         | 1.6 mm                                      |
|                                  | <b>D</b>           | SMD   |
| <b>Direction, latch style</b>    | <b>U</b>           | Horizontal (90°, side entry), latch up      |
|                                  | <b>D</b>           | Horizontal (90°, side entry), latch down    |
|                                  | <b>V</b>           | Vertical (180°, top entry)                  |
|                                  | <b>Y</b>           | Diagonal (45°), latch up                    |
| <b>Number of Ports</b>           | <b>1</b>           | 1 Port                                      |
|                                  | <b>12; 14; ...</b> | multi ports side by side, Multiport         |
|                                  | <b>21; 41; ...</b> | multi ports about each other, Multilevel    |
| <b>Assembly on PCB</b>           | <b>R</b>           | Through Hole Reflow - THR                   |
|                                  | <b>S</b>           | Soldering process: Wave or Reflow soldering |
|                                  | <b>S</b>           | Surface Mount Technology - SMT              |
|                                  | <b>T</b>           | Soldering process: Reflow soldering         |
|                                  | <b>T</b>           | Through Hole Technology - THT               |
|                                  | <b>T</b>           | Soldering process: Wave                     |
| <b>Performance Category</b>      | <b>C5</b>          | Category 5                                  |
|                                  | <b>C6</b>          | Category 6                                  |
|                                  | <b>C6A</b>         | Category 6A                                 |
|                                  | <b>C5e</b>         | Category 5e                                 |
|                                  | <b>M</b>           | 10/100 Mbit                                 |
|                                  | <b>G1</b>          | 10/100/1000 Mbit                            |
|                                  | <b>G10</b>         | 10 Gbit                                     |
|                                  | <b>U</b>           | Unshielded                                  |
|                                  | <b>MP</b>          | 10/100 Mbit with POE                        |
|                                  | <b>MP+</b>         | 10/100 Mbit with POE+                       |

Legenda

## Recommended reflow soldering profile

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com



### Reflow soldering profile

The perfect soldering profile for SMT Surface Mount Technology is one the most exiting question in SMT production. But there are more than one correct answer: The diagram of temperature-on-time is related to processing features of solder paste and to maximum load of components.

We have to consider the following parameters:

- Time for pre heating
- Maximum temperature
- Time above melting point
- Time for cooling
- Maximum heating rate
- Maximum cooling rate

We recommend a typical solder profile with associated process limits. With preheating components and board are prepared smoothly for the solder phase. Heating rate is typically  $\leq +3\text{K/s}$ . In parallel the solder paste is ‚activated‘. The time above melting point of 217°C the paste gets liquid and components and boards begin to connect. The maximum temperature of 245°C to 254°C should stay between 10 and 40 seconds. In the cooling phase at  $\geq -6\text{K/s}$  solder is cured. Board and components cool down while avoiding cold cracks.